

团 体 标 准

T/CEMIA 022—2019

多层布线用金导体浆料规范

Gold conductor paste for multilayer wiring

2019-09-25 发布

2019-12-25 实施

中国电子材料行业协会 发 布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国电子材料行业协会提出并归口。

本标准主要起草单位：西安宏星电子浆料科技股份有限公司。

本标准参与起草单位：中国电子科技集团公司第四十三研究所、中国电子科技集团公司第十四研究所、中国兵器工业第二一四研究所。

本标准主要起草人：赵莹、张建益、孙社稷、陆冬梅、王大林、崔国强、王璞、张亚鹏、刘丝颖、吴高鹏、周宝荣、郝武昌、肖雄、鹿宁、殷美、党丽萍、董耀辉、高亮、谢廉忠、王伟、李建辉、侯清健。

多层布线用金导体浆料规范

1 范围

本标准规定了多层布线用金导体浆料的定义、技术要求、检验方法、检验规则及包装、标志、运输、贮存。

本标准适用于由金粉、玻璃粉、有机载体以及添加剂组成,满足印刷特性的多层布线用金导体浆料(以下简称金导体浆料)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

SJ/T 11512—2015 集成电路用 电子浆料性能试验方法

3 术语和定义

3.1

方数 square number

浆料烧结膜图形的长/宽比值,单位符号用□表示。

4 技术要求

4.1 金导体浆料性能

金导体浆料性能应符合表 1 的规定。

表 1 金导体浆料性能

性能	细度/ μm	黏度 ^a Pa · s(25 °C ,10 rpm)	固体含量/%
参数指标	≤ 8	290—410	≥ 80.0
^a 黏度范围内的具体数值由供需双方协商确定。			

4.2 金导体浆料烧成膜性能

金导体浆料烧成膜性能应符合表 2 的规定。